

# Table of Contents

OverView .....	1
Specifications .....	1
OverView .....	1

## OverView

### Specifications

型号	IIM-3000
检测目标	Φ 300 mm Si Wafer (Polished, Etched) / N, P-, P+, P++
可检测缺陷	Buried-Airpocket, Surface Bump, Through-Hole
可检测最小气孔	APK ≥ 20 μm diameter Capture Rate (DSP): ≥ 95 % for 25 μm APK Capture Rate (Ground): ≥ 95 % for 30 μm APK
可检测信息	Diameter, Long-Short Ratio, Circularity X,Y,Z coordinate (Z means the depth of defect)
检测量	120 Wfrs/h (if no defect in Wafer)
尺寸	1450 mm (W) x 2300 mm (D) x 2010 mm (H)
重量	1300 Kg

### OverView

- IIM-3000可以检测300mm硅晶圆上的各类缺陷，可检测的缺陷类型如下：内部气孔、凸起、通孔。
- 先进的缺陷测量和分级算法，可以高速检测各类型的硅晶圆[N, P-, P+, P++]
- IIM-3000采用专用控制器，可提供最佳的控制性能，以及相当简便的设置和维护工作。
- 卓越的定制系统和软件，使IIM-3000可提供稳定可靠的检测结果。

From:

<https://www.comizoa.com/info/> - -

Permanent link:

<https://www.comizoa.com/info/doku.php?id=cn:equipment:eis3000:spec&rev=1587707504>

Last update: **2024/07/08 18:22**